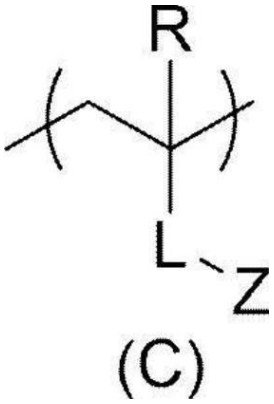
【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】令和5年5月9日(2023.5.9)

【国際公開番号】WO2022/044963
【出願番号】特願2022-544522(P2022-544522)
【国際特許分類】
*Ｂ３２Ｂ 27/28(2006.01)*
*Ｂ３２Ｂ 27/30(2006.01)*
*Ｇ０３Ｆ 7/004(2006.01)*
*Ｈ０５Ｋ 3/06(2006.01)*
【ＦＩ】
Ｂ３２Ｂ 27/28
Ｂ３２Ｂ 27/30 Ｄ
Ｇ０３Ｆ 7/004５１２
Ｇ０３Ｆ 7/004５０１
Ｈ０５Ｋ 3/06 Ｈ

【手続補正書】
【提出日】令和5年2月13日(2023.2.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
仮支持体と、前記仮支持体上に配置された樹脂組成物層とを有し、
前記樹脂組成物層が、樹脂と、
式（Ａ）で表される基又は式（Ｂ）で表される基を有する構成単位Ｘからなるブロックと、ポリ（オキシアルキレン）基を有する構成単位Ｙからなるブロックとを含むブロック共重合体、及び、
式（１）で表される化合物からなる群から選択される少なくとも１つの化合物とを含む、転写フィルム。
式（Ａ） ＊－（ＣＨ$_2$）$_m$－（ＣＦ$_2$）$_n$－ＣＦ$_3$
式（Ａ）中、ｍ及びｎは、それぞれ独立に、１～３の整数を表す。＊は結合位置を表す。
式（Ｂ） ＊－Ｌ$^1$－ＣＨ（ＣＦ$_3$）－ＣＦ$_3$
式（Ｂ）中、Ｌ$^1$は、酸素原子又はアルキレン基を表す。＊は結合位置を表す。
式（１） Ｚ－Ｌ$^2$－Ｗ
式（１）中、Ｚは、前記式（Ａ）で表される基、又は、前記式（Ｂ）で表される基を表す。
Ｌ$^2$は、単結合又は２価の連結基を表す。
Ｗは、ポリ（オキシアルキレン）基を含む基を表す。
【請求項２】
前記構成単位Ｘ、及び、前記式（１）で表される化合物が、前記式（Ａ）で表される基を有する、請求項１に記載の転写フィルム。
【請求項３】
前記構成単位Ｘ、及び、前記式（１）で表される化合物が、前記式（Ｂ）で表される基を有する、請求項１に記載の転写フィルム。

【請求項４】
前記式（１）で表される化合物を含み、前記式（１）で表される化合物の分子量が、２０００以下である、請求項１～３のいずれか１項に記載の転写フィルム。
【請求項５】
前記ブロック共重合体を含み、前記ブロック共重合体の重量平均分子量が、５０００以上である、請求項１～４のいずれか１項に記載の転写フィルム。
【請求項６】
前記樹脂が、アルカリ可溶性樹脂であり、
前記樹脂組成物層が、更に、重合性化合物を含む、請求項１～５のいずれか１項に記載の転写フィルム。
【請求項７】
前記樹脂が、酸分解性基で保護された酸基を有する構成単位を有する樹脂であり、
前記樹脂組成物層が、更に、光酸発生剤を含む、請求項１～５のいずれか１項に記載の転写フィルム。
【請求項８】
前記樹脂組成物層が、水溶性樹脂組成物層である、請求項１～７のいずれか１項に記載の転写フィルム。
【請求項９】
前記水溶性樹脂組成物層が、金属酸化物粒子を含む、請求項８に記載の転写フィルム。
【請求項１０】
前記樹脂組成物層が、熱可塑性樹脂組成物層である、請求項１～９のいずれか１項に記載の転写フィルム。
【請求項１１】
前記樹脂組成物層が、更に、顔料を含む、請求項１～１０のいずれか１項に記載の転写フィルム。
【請求項１２】
前記樹脂組成物層は、２層以上の前記樹脂組成物層である、請求項１～１１のいずれか１項に記載の転写フィルム。
【請求項１３】
前記ブロック共重合体を含み、前記ブロック共重合体の重量平均分子量が、５０００以上であり、前記構成単位Ｘが、式（Ｃ）で表される構造単位であり、
前記ブロック共重合体の含有量は、前記樹脂組成物層全質量に対して、０．０１～３．００質量％であり、
前記樹脂が、アルカリ可溶性樹脂であり、前記樹脂の含有量は、前記樹脂組成物層全質量に対して、２０．００～８０．００質量％であり、
前記樹脂組成物層が、更に、重合性化合物を含み、前記重合性化合物は、重合性基としてエチレン性不飽和基を有する、請求項１に記載の転写フィルム。
【化１】




(C)

式（Ｃ）中、Ｒは、水素原子又は置換基を表す。Ｌは、単結合又は２価の連結基を表す

。Ｚは、前記式（Ａ）で表される基、又は、前記式（Ｂ）で表される基を表す。
【請求項１４】
請求項１～１３のいずれか１項に記載の転写フィルムが有する前記仮支持体とは反対側の表面に基板を接触させて、前記転写フィルムと前記基板とを貼り合せ、転写フィルム付き基板を得る貼合工程と、
前記樹脂組成物層をパターン露光する露光工程と、
露光された前記樹脂組成物層を現像して樹脂パターンを形成する現像工程と、
更に、貼合工程と露光工程との間、又は、露光工程と現像工程との間に、転写フィルム付き基板から仮支持体を剥離する剥離工程とを含む、積層体の製造方法。
【請求項１５】
請求項１～１３のいずれか１項に記載の転写フィルムが有する前記仮支持体とは反対側の表面を、導電層を有する基板に接触させて、前記転写フィルムと前記導電層を有する基板とを貼り合せ、転写フィルム付き基板を得る貼合工程と、
前記樹脂組成物層をパターン露光する露光工程と、
露光された前記樹脂組成物層を現像して樹脂パターンを形成する現像工程と、
前記樹脂パターンが配置されていない領域における前記導電層をエッチング処理するエッチング工程と、
更に、貼合工程と露光工程との間、又は、露光工程と現像工程との間に、転写フィルム付き基板から仮支持体を剥離する剥離工程とを含む、回路配線の製造方法。
【請求項１６】
請求項１４に記載の積層体の製造方法を含む電子デバイスの製造方法であって、
前記電子デバイスが前記樹脂パターンを硬化膜として含む、電子デバイスの製造方法。